

Singulation System

Model FMS3040-HC



Half-cut machine suitable for wettable QFN packages

适用于Wettable QFN封装的Half Cut设备

- 可实现无Lead产品（如QFN产品）的高精度刀片切割
- 根据工艺和引线框架的设计，有刀片切割（FMS3040-HC）或激光切割（LGR1040）可供选择
- 利用翘曲矫正压机提高了Half Cut切割精度

产品信息



中文



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
机型		—	FMS3040-HC			
设备区分		—	半切割共用机		半切割专用机	
框架・基板尺寸	长度	mm	150—300			
	宽度	mm	40—100			
	厚度	mm	0.5—2.0			
产品尺寸	最小	mm	1×1			
	最大	mm	25×25			
基板翘曲量		—	3mm／300mm (Max.)			
切割引擎		—	Twin spindles, Twin tables			
外形尺寸	机类型	module	Cut Engine	Offload	Cut Engine	Offload
	宽度	mm	1,960	1,500	1,960	740
	纵深	mm	1,760	1,760	1,760	1,760
	高度	mm	1,800	1,800	1,800	1,800
重量		ton	5.1		3.2	
框架・基板供给部	类型	—	Slit magazine			
	数量	pcs	4 (Max.) 当弹匣宽度为115毫米时			
产品收纳机构	类型	—	Original Box		Slit magazine	
	数量	pcs	1		4 (Max.) 当弹匣宽度为115毫米时	
品种转换件更换时间		min	10		5	
产品传送方式		—	Vacuum			
产品处理能力		SPH	6			

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要可能有改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation

20250401-005-HQ